

東京開催 ワークショップのご案内

お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。このたび当社では最新の摩擦試験機やCMP評価用研磨装置につきまして、下記の日程でワークショップを催すことになりました。

当日は、アプリケーションサイエンティストの実演により製品の機能や性能をじっくりとご覧いただけるよう企画いたしておりますので、ご多忙のこととは存じますが、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具
ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部
事業部長 相川 重夫

記

- 開催日： 2018年3月15日（木） 13:00～16:30（予定）
- 開催場所：ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 東京事業所
〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1 住友不動産六甲ビル1F
「茅場町」駅徒歩4分（日比谷線・東西線）又は、「八丁堀」駅徒歩5分（日比谷線・JR京葉線）
- 内容：製品概要、特徴及び、事例などのご説明、実機を用いたデモンストレーション（参加費：無料）
- 製品： ① ユニバーサルトライボロジーテスター UMT-TriboLab
② CMP評価用研磨装置 TriboLab CMP
(製品の概略は裏面をご参照下さい)

- 申込み方法：
担当営業 鈴木 大輔 電話：03-3523-6361
E-Mail: Daisuke.Suzuki@bruker.comにご連絡ください。

※メールでお申込みの場合、タイトルに「東京WS申し込み」と明記いただき以下の項目をご記入ください。

- ・勤務先名 ・ご所属部署 ・お名前 ・メールアドレス
- ・ご住所 ・TEL ・ご興味のある製品

- プログラム：

ブルカー東京事業所 アクセス



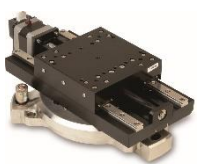
| 時間 | 内容 |
|-------------|---|
| 13:00～13:15 | 開会のご挨拶 |
| 13:15～14:30 | 「多機能摩擦摩耗試験機の最新モジュール」、「CMPプロセス開発を目的としたTriboLab CMPの紹介」ブルカージャパン(株)ナノ表面計測事業部 |
| 14:30～14:45 | 休憩 |
| 14:45～15:45 | 多機能摩擦摩耗試験機 デモンストレーション |
| 15:45～16:15 | CMP評価用研磨装置 デモンストレーション |
| 16:15～16:30 | 質疑応答 |
| 備考欄 | ※ デモは当日の参加人数によってグループを分けて対応させて頂く場合がございます。 ※ 個別の御質問等ある方はワークショップ終了後に対応致します。 |

製品紹介

多機能摩擦摩耗試験装置 UMT-Tribolab

最新世代のUMTは、多種多様なモジュール方式で設計されており、汎用性が高く、選択する構成によって、いくつもの異なる摩擦・摩耗試験が可能なメカニカル・トライボロジーテスターです。

- 1台のプラットフォームで45種類を超えるASTM規格に対応したトライボロジー試験が可能
ボール・ピンオンディスク、スラスト試験（リング・ディスクオンディスク）、往復試験、ブロックオンリング、スクラッチ試験、シェル式四球試験、腐食摩耗試験など
- 自動車分野に特化した様々なアプリケーションにも対応。
JASO M348及び、SAENo.2規格のクラッチ材評価、ASTMD6425などの潤滑油高速振動試験（SRV試験、JASO M358 ベルト式CVT油の金属間摩擦係数特性試験、SAEJ2522(AKMaster)のブレーキパッド試験など
- ノイズレベルをフルスケールの0.02%に低減させた11種類のフリクションロードセンサーにより、最小1mN～最大2,000Nの荷重印可が可能。
- AEセンサーによる材料の破壊検出やECRセンサーによる摺動中の通電状態など測定が可能
- モジュール方式で設計された環境制御チャンバーにより、様々な環境での試験が可能
加熱チャンバー（150℃、400℃、1000℃）、冷却チャンバー（-30℃）、湿度制御（5～85%RH）や真空中、任意ガス雰囲気中などの環境制御を実現



リニアドライブ



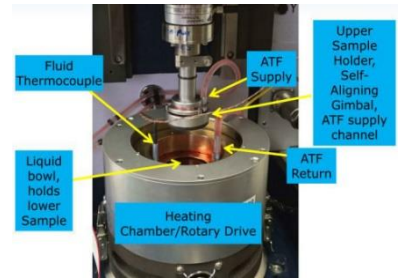
高速往復ドライブ



ロータリドライブ



ブロックオンリングドライブ



クラッチ試験セットアップ

CMPプロセス開発用研磨機 TriboLab CMP



半導体産業における最先端CMPプロセス開発用途で10年以上にわたってご活用いただいている装置です。すでに多くのお客様により優れた試験評価性能が実証されています。

- CMPプロセスの様々な性能評価を実現
 - ・ CMPプロセスで用いるパッド・スラリー・コンディショナーといった消耗材を評価します。
 - ・ フルスケールの研磨プロセス環境を再現できるため、製造設備を休止させて試験する必要はありません。
 - ・ 研磨プロセス中の摩擦係数やAE信号検出、温度計測を再現性よく測定することが可能です。
 - ・ ウェハサイズ2～4インチに対応。ウェハヘッドの全面にいくつも小さな試験片を簡単にセット可能です。
- 幅広い試験レンジ
 - ・ 4～400Nの荷重範囲を有し幅広い研磨圧に対応します。
 - ・ 2インチウェハ（50mm）： 0.29～29psi
 - ・ 4インチウェハ（100mm）： 0.07～7.2psi
 - ・ 1～500rpmの回転速度範囲を有し、独立し制御が可能です。
 - ・ スラリーや水用のポンプは2.2～480mL/minの範囲でコンピューター制御可能です。

